

株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月開催
基準日	期末配当金 毎年3月31日 中間配当金 毎年9月30日 そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日
単元株式数	100株
株主名簿管理人および 特別口座の口座管理機関	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
株主名簿管理人 同事務取扱場所 (郵便物送付先)	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 〒168-0063東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(電話照会先)	☎0120-782-031
(インターネットホームページURL)	https://www.smtb.jp/personal/agency/index.html
公告の方法	当社のホームページに掲載する https://www.ferrotec.co.jp/
上場証券取引所	株式会社東京証券取引所 JASDAQスタンダード

・株式に関する住所変更等のお届出およびご照会について

証券会社の口座をご利用の場合は、三井住友信託銀行ではお手続きができませんので、取引証券会社へご照会ください。証券会社の口座のご利用がない株主様は、上記電話照会先までご連絡ください。

年間IRカレンダー



Ferro Tec

株式会社 フェローテックホールディングス

〒103-0027

東京都中央区日本橋2-3-4 日本橋プラザビル5階

TEL 03-3281-8808 FAX 03-3281-8848

URL <https://www.ferrotec.co.jp/>

UD FONT

見やすいユニバーサルデザインフォント
を採用しています。



森林に配慮して適切に管理された
森林認証紙を使用しています。



環境に配慮した植物油インキを
使用しています。

第40期 決算報告

2019年4月1日～2020年3月31日

証券コード：6890



Ferro Tec

株式会社 フェローテックホールディングス

株主の皆さまへ



代表取締役社長
グループCEO
賀 賢漢

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

新型コロナウイルス感染症により、影響を受けられました皆さまにお見舞い申し上げます。ここに第40期決算報告をお届けするにあたりご挨拶申し上げます。

この度、代表取締役社長を拝命いたしました賀 賢漢でございます。

これまで代表取締役副社長兼執行役員事業統括担当として、既存事業の变革と事業領域の拡大を推し進め、弊社グループの成長の一助として努めてまいりました。

今後も企業価値の向上を目指してまいりますので、よろしくお願い申し上げます。

今期は新型コロナウイルス感染症の影響により、決算関連手続きに遅れが生じたため、決算発表を延期しましたことをご詫び申し上げます。

定時株主総会では、決議事項の承認のみを執り行い、第40期の期末配当金は1株当たり12円でご承認賜りました。また、同総会において連結計算書類等の報告事項は継続会で実施する旨をご承認賜り、先ごろ無事に継続会が終了いたしましたことをご報告申し上げます。

当社グループが属するエレクトロニクス産業では、米中貿易摩擦の長期化の影響もあり、半導体メーカーの設備投資は年間を通して調整局面で推移しました。当社グループのマテリアル製品の販売も伸び悩みました。一方で中国半導体市場の需要にお応えするため杭州市に大口径シリコンウエーハ工場を竣工いたしました。液晶パネルやICチップなどの製造設備の部品洗浄サービスは好調であり売上に貢献いたしました。

移动通信システム業界では、海外で第5世代通信がスタートし、通信速度の改善により遠隔医療も現実的なものとなります。当社グループでは、コア製品であるサーモジュールを移动通信システム業界に供給しており、通信機器や中継機器などに利用されています。今後は、データセンター用サーバーの増設などにより、半導体業界の回復も期待できると見込んでいます。

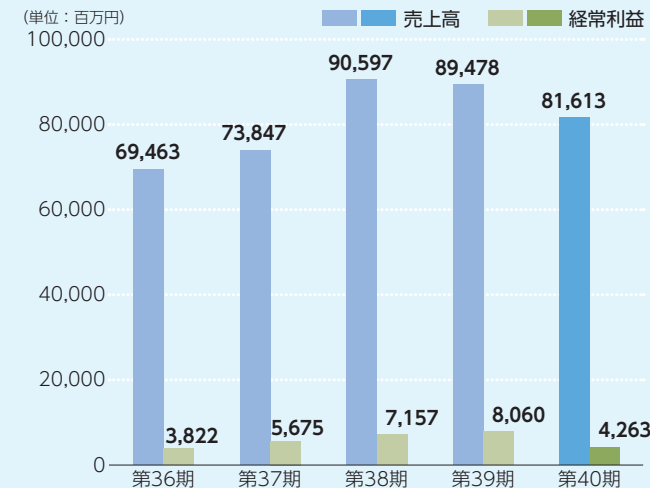
当社グループの経営の基本方針に基づき、株主の皆さまにとって「成長する楽しみが持てる企業」であり続けることに努めてまいります。

株主の皆さまにおかれましては、今後とも格別のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

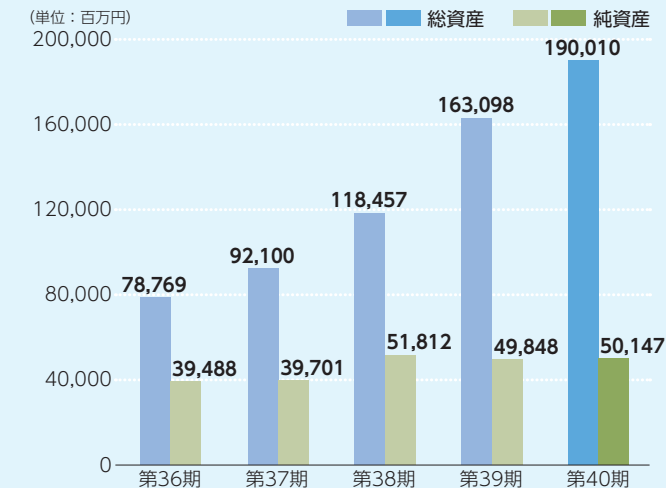
2020年8月吉日

財務ハイライト

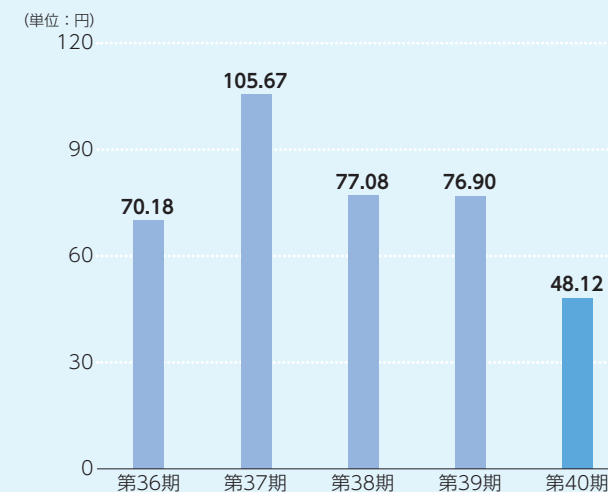
売上高／経常利益



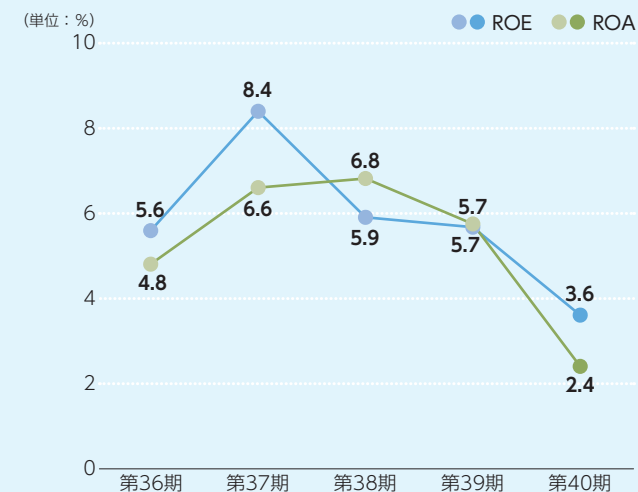
総資産／純資産



1株当たり当期純利益



ROE(自己資本当期純利益率)／ROA(総資産経常利益率)



特集 1 SDGsの取り組み

企業理念に基づき、昨今世界的なトレンドとなっている「SDGs(持続可能な開発目標)」を前提に、当社としてもESG(環境・社会・ガバナンス)の取組みを強化していきます。

企業理念	顧客に満足を	地球にやさしさを	社会に夢と活力を
顧客のサステナビリティ経営の理念、社会貢献の方針に共鳴し、当社製品・サービスを通じてその達成の一翼を担う	地球環境への配慮を前提とした活動を積極的に推進し、当社製品を通じて地球環境問題解決に向けた貢献を図る	当社のコア技術を活用したものづくりの分野で社会に貢献し、顧客・株主・社員・取引先・地域社会など、あらゆるステークホルダーに信頼される成長企業を目指す	

当社が特定するSDGsのマテリアリティ(重要課題)

E 環境	7 再生可能エネルギー	12 持続可能な消費と生産	13 気候変動への対応	17 パートナーシップ	環境汚染に配慮し、温室効果ガス排出低減へ貢献	<ul style="list-style-type: none"> 製品供給を通じた環境対策への貢献 事業活動における環境対策への対応 (ISO14001/エコアクション21)
	3 持続可能な健康と福祉	17 パートナーシップ			コア技術を活用し、すべての人の健康維持・増進のために貢献	<ul style="list-style-type: none"> サーモモジュールを通じた、DNA/血液分析。磁性流体を通じた体外診断薬など医療・健康分野に関する貢献
S 社会	9 持続可能な産業とインフラ	8 持続可能な雇用と経済成長			ハイテク分野の部材供給を通じ、半導体、自動車関連の技術革新、インフラ整備に貢献	<ul style="list-style-type: none"> マテリアル製品、シリコンウエーハなどを通じ、IoT、AIなどを活用したデジタルインフラ整備に貢献。またEVや自動運転など車の技術革新に対応
	8 持続可能な雇用と経済成長				多様な人材の活用と育成 従業員のエンゲージメント向上	<ul style="list-style-type: none"> 優秀な人材確保、キャリア形成支援 生き生きとした職場環境の整備
G ガバナンス	16 平和と公正				コンプライアンスの遵守とリスクマネジメントの強化	<ul style="list-style-type: none"> 法令遵守、内部通報窓口の周知徹底、非常時を想定したリスクマネジメント
	17 パートナーシップ				ステークホルダーへの積極的開示	<ul style="list-style-type: none"> 中長期的な経営戦略の開示 (継続) 取締役会実効性の評価と改善

当社を支えるあらゆるステークホルダーを尊重し、共生を図る事で、サステナブルな社会の実現に貢献し、企業としても持続的な成長を実現していきます。

G フェローテックグループを支える主なステークホルダー

ステークホルダー	概要
顧客	当社には、世界中に半導体、エレクトロニクス、自動車、医療、エネルギーなど、各分野の顧客がいます。
地域・社会	当社は、世界における各地域・社会と共生し、グローバルな事業展開をしています。
投資家	当社は、個人投資家、国内・海外機関投資家、金融機関、信託銀行、証券会社などの投資家のサポートを受け、事業を展開しています。
取引先・提携先	当社は、世界中の仕入れ先、および事業提携先と繋がり、共生する事で、事業活動を展開しています。
従業員	当社には、連結で7,000名を超える従業員がいます。

G コーポレートガバナンスの取り組み状況(2001年6月～2020年1月)

当社のコーポレートガバナンス体制

```

graph TD
    A[株主総会] -- 選任・監督 --> B[取締役会]
    A -- 監督 --> C[監査役会]
    B -- 選任・監督 --> D[代表取締役社長]
    C -- 監督 --> D
    D -- 監督 --> E[執行役員会]
    E -- 監督 --> F[内部監査室]
    F -- 監督 --> G[経営管理組織]
    G -- 監督 --> H[各子会社]
    I[独立監査人] -- 会計・内部統制監査 --> E
    J[弁護士] -- 相談 --> B
    K[弁護士] -- 相談 --> G
    
```

コーポレートガバナンスの取組状況

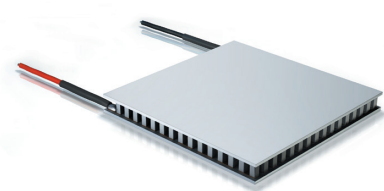
年度	項目	取締役				監査役		
		社内	社外	外国籍	合計	社外	社内	
2001	6月 22期	5	0	1	6	0%	1	3
2002	23期	6	0	1	7	0%	0	3
2003	24期	5	0	1	6	0%	0	3
2004	25期	6	0	1	7	0%	0	3
2005	6月 26期	4	1	1	6	17%	0	3
2006	5月 27期	4	1	2	7	14%	1	2
2007	6月 28期	5	1	2	8	13%	1	2
2008	4月 29期	6	1	1	8	13%	0	3
2008	10月 29期	6	1	1	8	13%	0	3
2009	6月 30期	6	2	1	9	22%	0	3
2010	31期	3	3	1	7	43%	0	3
2011	6月 32期	3	3	1	7	43%	0	4
2012	33期	3	3	1	7	43%	0	4
2013	5月 34期	3	3	1	7	43%	0	3
2014	35期	5	3	1	9	33%	0	3
2015	7月 36期	6	2	1	9	22%	0	3
2016	37期	6	2	1	9	22%	0	3
2017	38期	4	2	1	7	29%	0	3
2018	3月 38期	4	2	1	7	29%	0	3
2019	6月 40期	5	2	1	8	25%	1	2
2020	1月 40期	5	2	1	8	25%	1	2

E 環境汚染に配慮した、温室効果ガス排出低減への貢献

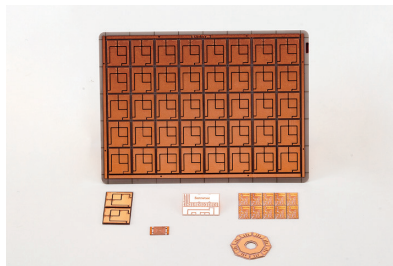


当社製品を通じた貢献

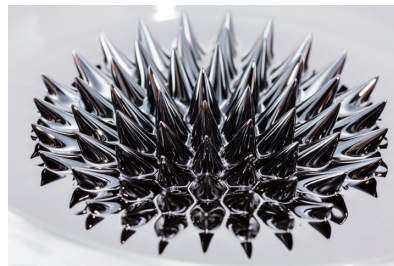
- フロンガス不使用の「サーモモジュール」による各分野での温度調整
- 「パワー半導体基板」を通じた消費電力削減への貢献
- 「磁性流体」を用いた音響スピーカーでの消費電力低減



ノンフロン[®]の温調デバイス
「サーモモジュール」



産業・民生機器、車載IGBT向け
「パワー半導体基板」



放熱、ダンパー用途の
「磁性流体」

当社事業活動を通じた貢献

- 太陽光パネルを用いたクリーンエネルギーでの発電(千葉工場、中国子会社)
- ISO14001認証をベースとした産業廃棄物の削減、物流資材の削減(千葉工場、中国子会社)
- 環境省「エコアクション21」認証をベースとした二酸化炭素排出量削減、工業用水排水量削減・再利用、化学物質管理の遵守(石川工場、関西工場、石川開発センター)



太陽光パネル



ISO14001認証



石川工場

地域別売上高構成比

※()は前期の数字



欧米 **32%**(35%)

フェローテックヨーロッパ(ドイツ)



各エリア別の
ポテンシャル



欧米エリア

- 5G、データセンター向けメモリ投資再開における米国半導体製造装置向けマテリアル製品(石英・セラミックス・CVD-SiC等)の需要回復
- 欧米向け医療・バイオ分野における安定したサーモモジュール、磁性流体需要
- コロナ影響から、自動車向け各種製品需要は一時的に調整



アジアエリア

- 旺盛な中国、韓国、台湾での半導体ファブリー・メモリ向け投資、および中韓での有機ELパネル新規投資再開による、真空シール、マテリアル製品、および装置部品洗浄事業の伸長
- 中国を中心とした5G通信基地局インフラ投資拡大によるサーモモジュール製品の需要拡大
- コロナ影響から、自動車向け各種製品、および工作機械向けパワー半導体基板需要は一時的に調整

日本 **18%**(19%)

フェローテック本社

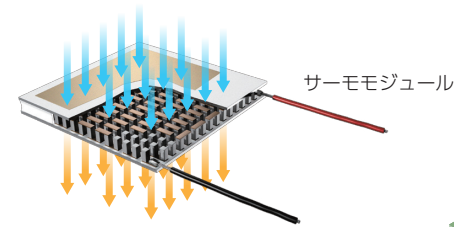


日本国内

- リモートワーク、WEB学習、動画配信サービス拡大による安定した半導体需要、およびメモリ投資再開による製造装置メーカー、デバイスメーカー向けマテリアル製品の需要拡大
- 医療・バイオ、およびウェアラブル分野における安定したサーモモジュール、磁性流体需要

あらゆる産業で期待される次世代通信システム5G。 未来を見据えた需要にもフェローテックは貢献します。

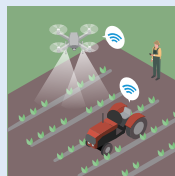
移動通信業界では、第5世代通信の5Gがいよいよスタートします。
自動運転や遠隔医療が実現されようとしているなか、
フェローテックの半導体冷熱素子サーモモジュールは
5G無線基地局や中継局に活用されています。



サーモモジュール

スマート農業

ロボット技術や情報通信技術を活用して、省力化・精密化や高品質生産を実現する新たな農業です。



遠隔医療

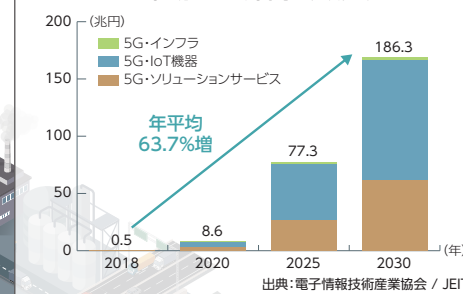
高速大容量通信により高精細な映像のやりとりが可能になるため、医師と遠く離れた場所にいる患者が正確な診断を受けることが可能となります。



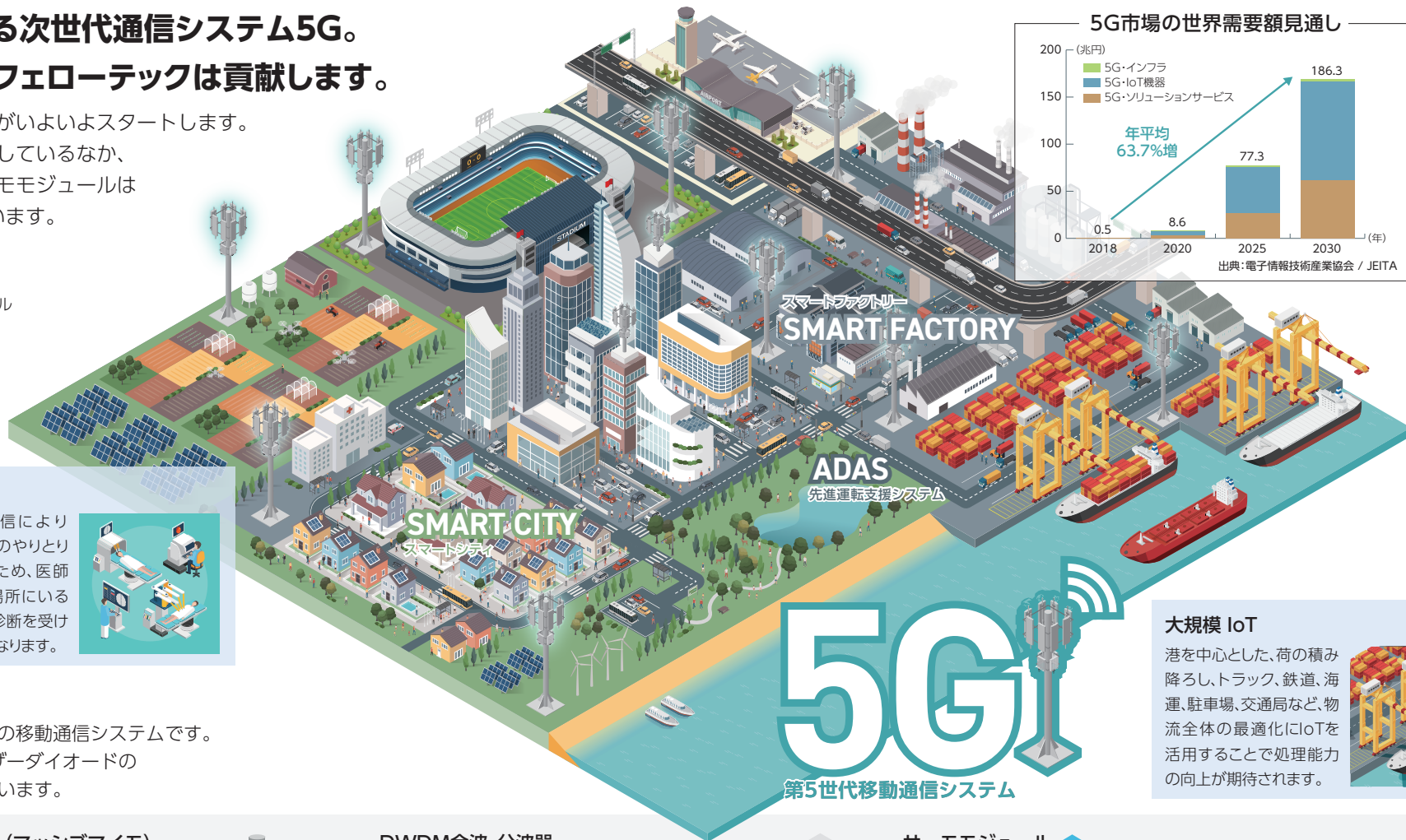
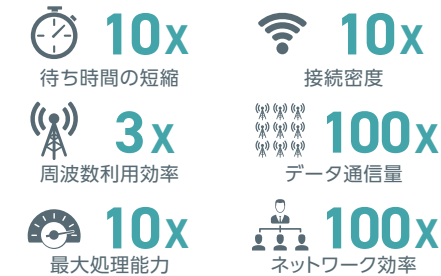
5Gの仕組み

5Gは「高速大容量」「多接続」「低遅延」を実現するための移動通信システムです。
フェローテックのサーモモジュールは光通信用レーザーダイオードの温度調節を行い、波長を安定させるために活用されています。

5G市場の世界需要額見直し



4Gとの比較



エンターテインメント

仮想現実(VR)や拡張現実(AR)のような最新テクノロジーでは、映像や3DCGなど大容量コンテンツがサービスとして提供されるため、高速かつ大容量な通信が必要です。



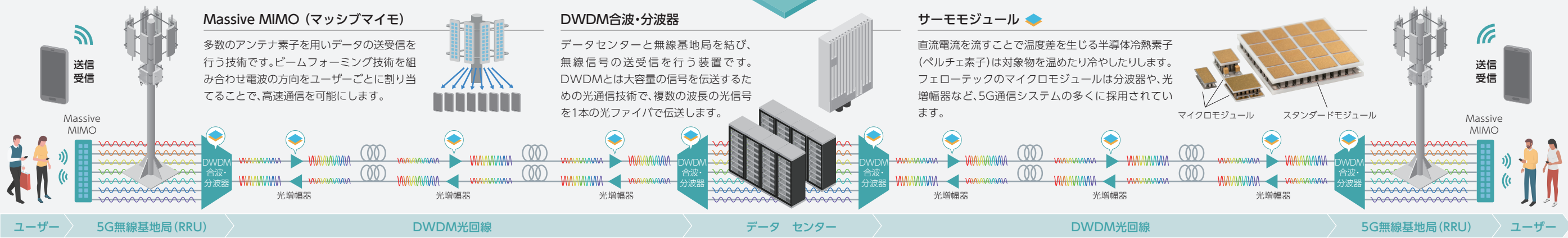
大規模 IoT

港を中心とした、荷の積み降ろし、トラック、鉄道、海運、駐車場、交通局など、物流全体の最適化にIoTを活用することで処理能力の向上が期待されます。



自動運転

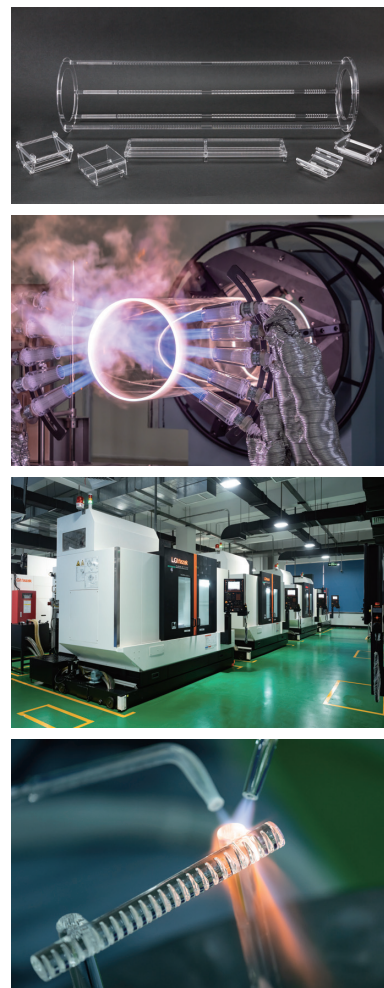
自動運転には、AIをはじめ、カメラや超音波センサー、GPS、信号機との連携、自動ブレーキなど、さまざまな装備と技術が必要とされます。



特集 3 石英製品

熱と化学変化に強い超高純度ガラス

高熱処理や化学処理が頻繁に行われる半導体製造工程。そこで活躍するのが、超高純度のシリカガラスからなる石英製品です。ウエーハの薄膜生成や拡散プロセス、その他搬送、洗浄工程で治具、消耗品として利用される当社の石英製品は、細線化、高純度化の進む半導体プロセスにおいて重要な役割を担っています。



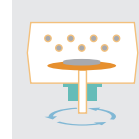
石英製品の事例

CVD装置



CVDは化学気相成長と呼ばれる薄膜製膜技術の一つです。加熱された基板に製膜を行いたい成分を含むガスを供給し、基板表面における化学反応により膜を堆積させます。

エッチング装置



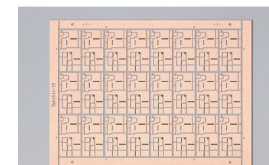
エッチングとは薬液や反応ガスの腐食作用を利用した表面加工方法です。半導体製造においてはウエーハにパターン形成する際の薄膜除去方法として使用されます。

特集 4 パワー半導体用DCB & AMB基板

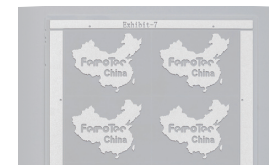
サーモモジュール製造技術を応用した放熱用絶縁基板

回路基板では一般的に低電力の家電製品やPCなどでは有機系基板や金属基板が多く使用されていますが、大電力を扱うパワーモジュールの放熱絶縁基板としてはアルミナ、窒化アルミ、窒化ケイ素の基板が利用されます。特に、HEVやEV車の販売台数増加に伴うインバータ/コンバータのパワーモジュール向けでは窒化ケイ素基板が注目されており、当社では従来製品のDCB(Direct Copper Bonding)基板に加えて、新製品となるAMB(Active Metal Brazing)基板の量産を開始しました。小型化・省エネ化に寄与し、今後の成長が期待されています。

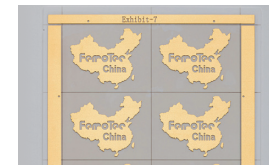
DCB Direct Copper Bonding



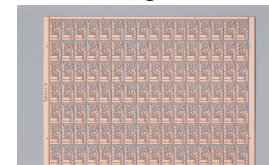
Al₂O₃ DCB (ZTA) アルミナ



Al₂O₃ DCB (Ag) アルミナ

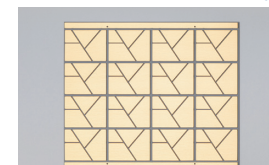


Al₂O₃ DCB (Au) アルミナ



Al₂O₃ DCB アルミナ

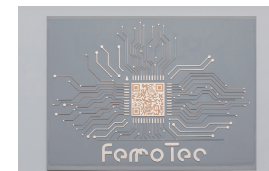
AMB Active Metal Brazing



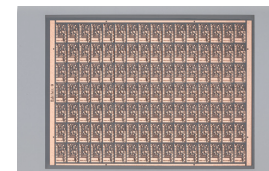
SiN AMB (Au) 窒化ケイ素



SiN AMB (Cu) 窒化ケイ素



SiN AMB (Ni) 窒化ケイ素



SiN AMB 窒化ケイ素

中国におけるパワー半導体用基板工場拠点マップ



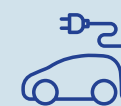
パワー半導体の主なアプリケーション



送電システム



電車



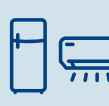
電動車両



生産設備



太陽電池



白物家電

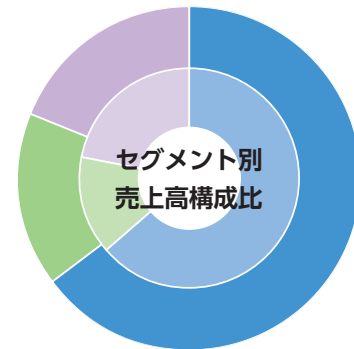


パソコン



サーバー機

セグメント別事業概況



当社は、製品用途の類似性と販売先業種により区分し「半導体等装置関連事業」「電子デバイス事業」の2事業を報告セグメントとしております。

	第39期 (内周)	第40期 (外周)
半導体等装置関連事業	63.7%	64.8%
電子デバイス事業	14.4%	16.5%
その他	21.9%	18.7%

半導体等装置関連事業

主力の真空シールは、半導体および有機ELパネルなどの製造装置内に装着され、密封空間を保持する機能部品です。半導体や有機ELパネルメーカーの設備投資の調整局面が続いた結果、同製品と受託加工の売上は前年比で減収となりました。また、半導体のウエーハプロセスに使用されるマテリアル製品(石英・セラミックス等)は、各種メモリの価格が需給バランスにより下落し、デバイスメーカー各社が在庫調整を継続したため、需要は弱いものとなりました。シリコンウエーハ加工は、一定の水準で推移しました。半導体製造装置、有機ELパネル製造装置などの部品洗浄の売上は、新工場の稼働により伸びました。

売上高 **528**億円 営業利益 **41**億円



セラミックス製品

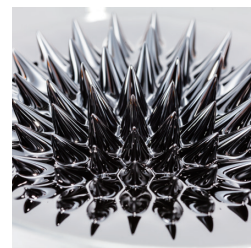


真空シール

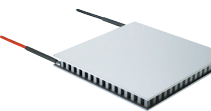
電子デバイス事業

主力のサーモモジュールは、自動車温調シート向けが北米市場および中国市場での自動車販売台数の前年割れにより、軟調な展開が続きました。5G用の移動通信システム機器、PCR等の医療検査装置向けは概ね計画のとおり推移しましたが、その他の産業用途は、米中貿易摩擦の長期化の影響で、顧客の在庫調整が発生し、前年比で減収となりました。パワー半導体用基板は、DCB基板が成長著しく、順調に売上を伸ばし、新開発のAMB基板は、数多くの顧客において認定取得中です。磁性流体は、スピーカー向けとスマートフォン用途の需要がやや減少となりました。

売上高 **134**億円 営業利益 **27**億円



磁性流体



サーモモジュール

※ 記載金額は、億円未満を切り捨てて表示しております。
各セグメントの売上高は、外部顧客に対する数値を記載しております。

連結財務諸表(要約)

決算情報についての最新情報、詳細につきましては当社のIRサイトをご覧ください。
<https://www.ferrotec.co.jp/ir/>



連結貸借対照表

(単位:百万円)

科目	当期 2020年3月31日現在	前期 2019年3月31日現在
資産の部		
流動資産	71,451	77,271
固定資産	118,558	85,827
有形固定資産	110,816	76,133
無形固定資産	500	3,557
投資その他の資産	7,241	6,136
資産合計	190,010	163,098
負債の部		
流動負債	61,443	60,180
固定負債	78,418	53,069
負債合計	139,862	113,250
純資産の部		
株主資本	46,942	45,793
その他の包括利益累計額	1,452	3,705
新株予約権	73	26
非支配株主持分	1,679	323
純資産合計	50,147	49,848
負債純資産合計	190,010	163,098

※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科目	当期 2019年4月1日から 2020年3月31日まで	前期 2018年4月1日から 2019年3月31日まで
営業活動による キャッシュ・フロー	8,902	11,466
投資活動による キャッシュ・フロー	△34,472	△37,063
財務活動による キャッシュ・フロー	17,996	34,507
現金及び現金同等物に係る 換算差額	△395	△1,003
現金及び現金同等物の 増減額(△は減少)	△7,968	7,906
現金及び現金同等物の 期首残高	31,555	23,648
連結の範囲の変更に伴う現金及び 現金同等物の増減額(△は減少)	122	—
現金及び現金同等物の 期末残高	23,709	31,555

※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結損益計算書

(単位:百万円)

科目	当期 2019年4月1日から 2020年3月31日まで	前期 2018年4月1日から 2019年3月31日まで
売上高	81,613	89,478
売上原価	54,685	62,341
売上総利益	26,928	27,137
販売費及び一般管理費	20,915	18,354
営業利益	6,012	8,782
営業外収益	1,612	1,053
営業外費用	3,361	1,776
経常利益	4,263	8,060
特別利益	523	648
特別損失	1,246	3,066
税金等調整前当期純利益	3,540	5,642
法人税等	1,897	2,819
当期純利益	1,642	2,822
非支配株主に帰属する当期純利益又は 非支配株主に帰属する当期純損失(△)	△142	△23
親会社株主に帰属する当期純利益	1,784	2,845

※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結包括利益計算書

(単位:百万円)

科目	当期 2019年4月1日から 2020年3月31日まで	前期 2018年4月1日から 2019年3月31日まで
当期純利益	1,642	2,822
その他の包括利益	△2,283	△3,754
その他有価証券評価差額金	△76	△52
為替換算調整勘定	△2,169	△3,677
退職給付に係る調整額	△5	12
持分法適用会社に対する持分相当額	△32	△36
包括利益	△640	△931
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	△467	△898
非支配株主に係る包括利益	△172	△32

※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

株式情報 / 会社情報 (2020年3月31日現在)

株式の状況

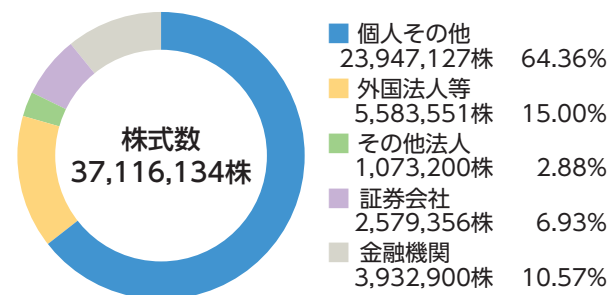
発行可能株式総数	67,000,000株
発行済株式総数	37,209,702株
株主数	23,257名

大株主

株主名	持株数(株)	持株比率(%)
山村 章	833,200	2.24
野村信託銀行株式会社(投信口)	700,000	1.88
JP MORGAN CHASE BANK 385166	556,800	1.49
岩崎 泰次	485,500	1.30
株式会社三菱UFJ銀行	420,000	1.13
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	418,800	1.13
三井住友信託銀行株式会社	400,000	1.07
松井証券株式会社	358,000	0.96
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505044	324,800	0.87
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103	309,770	0.83

(注) 1. 当社は、自己株式93,568株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2. 表示単位未満を切り捨てて表示しております。

所有者別株式分布状況



(注) 1. 自己株式93,568株は上記の円グラフ中の株式数に含まれておりません。
2. 表示単位未満を切り捨てて表示しております。

会社概要

商号	株式会社フェローテックホールディングス (英文表記) Ferrotec Holdings Corporation
設立	1980年9月27日
資本金	176億4,928万5,702円
株式公開	株式会社東京証券取引所 JASDAQ 1996年10月18日(証券コード: 6890)
決算期	3月31日
従業員数	7,533名(連結)

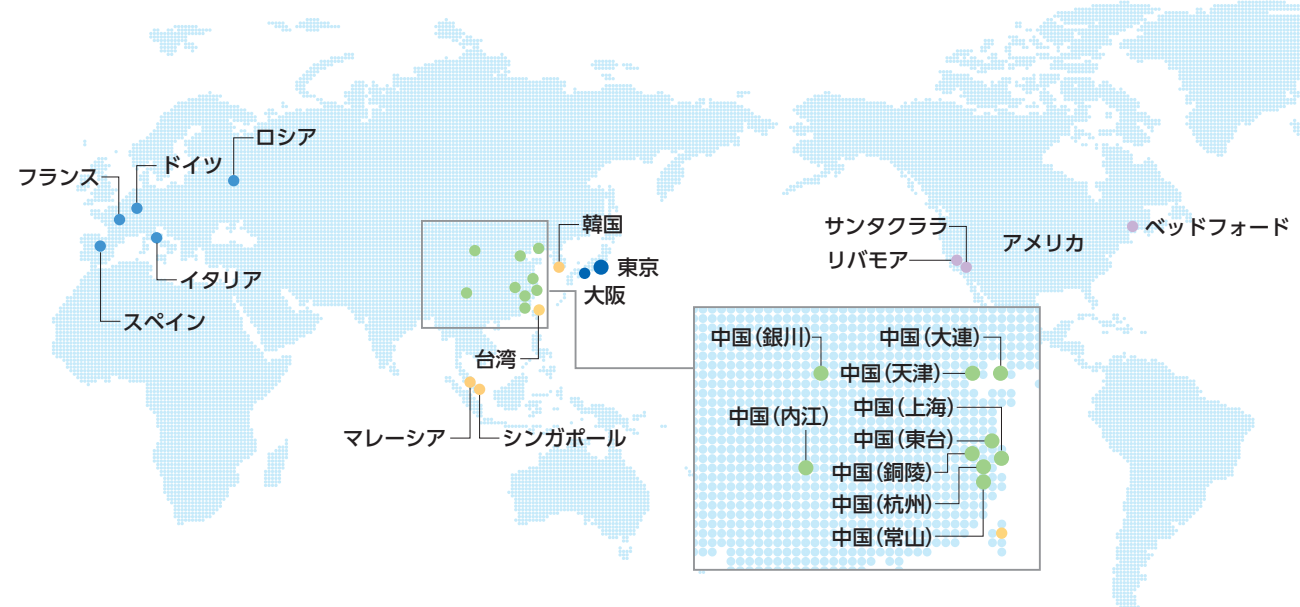
所在地

本社	〒103-0027 東京都中央区日本橋2-3-4 日本橋プラザビル5階
----	---

役員 (2020年7月31日現在)

取締役	
代表取締役会長	山村 章
代表取締役社長	賀 賢 漢
代表取締役副社長	山村 丈
取締役	若木 啓男
取締役	鈴木 孝則
取締役	宮永 英治
社外取締役	中村 久三
社外取締役	柳澤 邦昭
監査役	
常勤社外監査役	樋口 隆昌
社外監査役	藤本 豪
監査役	吉田 勝

グローバルネットワーク



欧州

- フランクフルト (ドイツ)
- シュツットガルト(ドイツ)
- モスクワ (ロシア)
- リヨン(フランス)
- ミラノ(イタリア)
- マドリッド(スペイン)

中国

- 杭州
- 上海
- 銀川
- 天津
- 内江
- 大連
- 東台
- 銅陵
- 常山

東南アジア

- シンガポール
- 新竹 (台湾)
- ウィワン (韓国)
- タンジン(韓国)
- クアラルンプール(マレーシア)

日本

- 東京[本社]
- 千葉
- 兵庫
- 石川
- 大阪
- 岡山
- 神奈川
- 山形
- ベッドフォード
- リバモア
- サンタクララ

販売拠点 生産拠点